8414
ACF

产品 信息

各向异性导电热反应粘接薄膜

产品描述

tesa® HAF 8414 ACF 是一款各向异性导电半透明热反应型胶带，其中包含了导电颗粒。

tesa® HAF 8414 ACF 特性：
*粘贴后各向异性导电
*一步机械模块固定与电联通
*在所有常见的注入产线上可操作
*适合于PVC, ABS卡（DI）和非接触卡片
*适合于银色油墨表面（RFID）和天线

平均粒径：40 µm

特点

- Chip module bonding and electrical connectivity in one step
- Good workability on all common implanting lines
- Suitable for PVC, ABS and PC cards (Dual Interface (D.I.) and contactless cards)
- Suitable for silver ink substrates and wire antenna
- Mean particle diameter: 40 µm

应用

tesa® HAF 8414 ACF 可用于需要可靠电气连接及强度粘贴的所有应用中。主要的应用是芯片模块植入到双界面卡（DI）及RFID标签的连接。

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范.

产品结构

• 基材	无	• 离型纸类型	玻璃纤维纸
• 胶粘剂类型	共聚酰胺	• 颜色	半透明

附加信息

技术参数推荐：
请注意，最佳工艺参数强烈取决于机器的类型，特别是卡身，天线材料或芯片模块的材料以及客户的要求。粘贴时间取决于使用表面的热转移。另外我们推荐在粘贴步骤之后直接冷却。因此压力应持续直到薄膜温度低于软化温度（约110 °C）

以下数据是推荐的机器初始设定的参数。

1. 预贴：

如需查询有关产品的最新信息，请访问 http://l.tesa.com/?ip=08414

8414
ACF

产品 信息

附加信息

在预贴过程中，胶带贴在模块带上。这个步骤可以在线或者离线进行。精确的预贴对于HAF 8414 ACF 是极其重要的，为了保证良好的粘贴力和在最终产品中良好的导电性。

机器设定：
*温度 130 – 150 °C
*压力 3– 4 bar
*时间 2.5 m/min.

2. 导电粘贴：
在模块嵌入过程中， 预贴模块是模块带上模切件定位到卡腔内，然后加热永久固定到卡身里。这个步骤确切的操作取决于注入线的类型。现在，有两种最常用的方式：

单步操作-机器设定
*温度[1] 160 – 220 °C
*压力 65 - 130 N/module
*时间 1,5 s

多步骤操作（2次或以上加热贴合）-机器设定：

- 温度[1] 180 – 220 °C
- 压力 65 - 130N/module
- 时间 (每个步骤)2 x 0,7 s. / 3 x 0.5 s.

温度建议参考热压头内测量所得，不同的温度设置是推荐用于不同的卡片材料：
PVC 180 – 190 ° C
ABS 180 – 190 ° C
PET 190 – 200 ° C
PC 200 – 220 °C

为达到最佳的粘接强度，粘接表面应干净干燥。储存条件符合tesa® HAF保质期原则。

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 http://l.tesa.com/?ip=08414